

(18)

Searching PAJ

1/1 ページ ③

Cite No. 5

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(1) Publication number : 06-302857

(43) Date of publication of application : 28.10.1994

(51) Int.Cl.

H01L 33/00

(21) Application number : 06-064528

(71) Applicant : HEWLETT PACKARD CO (HP)

(22) Date of filing : 06.03.1994

(72) Inventor :
KISH FRED A
STERANKA FRANK M
DEFEVERE DENNIS C
ROBBINS VIRGINIA M
UEBBING JOHN

(30) Priority

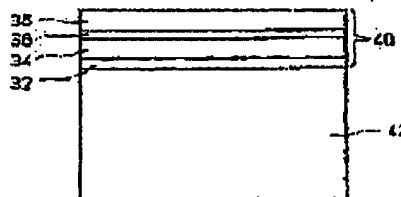
Priority number : 93 36532 Priority date : 19.03.1993 Priority country : US

(54) MANUFACTURE OF LIGHT EMITTING DIODE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a method of manufacturing a light emitting diode which has desired mechanical characteristics and transmittivity and is capable of minimizing the resistivity at the interface between a transparent layer and growth layer.

CONSTITUTION: Light emitting diode layers 32, 34, 36, 38 are grown on a temporarily grown substrate to form a comparatively thin layer type light emitting diode structure 40. This substrate is removed and conductive and light-permeable substrate 42 is wafer-bonded to the diode layer 32 to be a lower buffer layer, instead of the temporarily grown substrate, thereby manufacturing a light emitting diode.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3532863

[Date of registration] 12.03.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C), 1988-2003 Japan Patent Office

<http://www19.ipdl.ncpip.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAACoaqFPDA406302857> 2005/12/14

②

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-302857

(43)公開日 平成 6年(1994)10月28日

(51)Int.Cl. ³ H 0 1 L 33/00	識別記号 A 7376-4M N 7376-4M	庁内整理番号 F I	技術表示箇所
---	--------------------------------	---------------	--------

審査請求 未請求 発明の数 1 F D (全 17 頁)

(21)出願番号 特願平6-64528
(22)出願日 平成 6年(1994) 3月 8日
(31)優先権主張番号 0 3 6, 5 3 2
(32)優先日 1993年 3月19日
(33)優先権主張国 米国 (U S)

(71)出願人 590000400
ヒューレット・パッカード・カンパニー
アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル
ト ハノーバー・ストリート 3000
(72)発明者 フレッド・エイ・キッシュ
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ
レイク・ショアー・サークル 1372
(72)発明者 フランク・エム・ステランカ
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ
オーグラディ・ドライブ 7088
(74)代理人 井理士 遠藤 恭

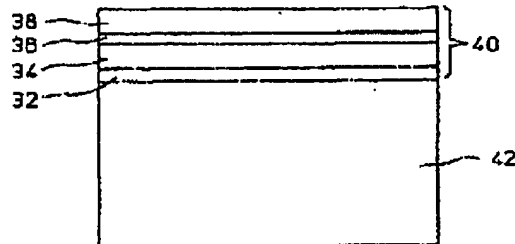
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 発光ダイオードの製造方法

(57)【要約】

【目的】 所望の機械的特性と透光性を有する発光ダイオードを製造することができ、かつ透明層と成長層との境界面の抵抗率を最小限にすることができる発光ダイオードの製造方法を提供することを目的とする。

【構成】 一時的成長基板上に発光ダイオード層 3 2, 3 4, 3 6, 3 8を順次成長させ、比較的薄い層の発光ダイオード構造 4 0を形成後、一時的成長基板を除去し、一時的成長基板に代えてその位置に下層の緩衝層となる発光ダイオード層 3 2に導電性、透光性基板 4 2をウェーハ接合して発光ダイオードを製造する。



(2)

特開平 6-302857

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所望の機械特性を有する発光ダイオード層（32、34、36及び38）の製造と適応性がある特性を有する第 1 材料を選択し；選択された第 1 材料から成る第 1 基板（30）を設け；第 1 基板上に発光ダイオード層を製造することによって発光ダイオード基板（40）を形成し；発光ダイオード構造の性能の向上に適する透光性材料を選択し；および選択された透光性材料の透明層（42）を発光ダイオード層にウェーハ・ボンディングする；工程とからなる発光ダイオードの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、一般に発光ダイオードに関し、特に発光ダイオードの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 発光ダイオード（以下、LEDという）は広範な用途に利用されている。例えば、光データ伝送では、LEDは光ファイバ・ケーブルに沿ってデータ信号を送送するために利用されている。

【0003】 レーザーとは異なり、LEDは良好に集束された光ビームを生成しない。対照的にLEDは全方向に光線を放射する。すなわち、発光は等方性である。多くの従来のLEDの層はLEDの能動領域の放射エネルギーよりもエネルギー・ギャップが少ない光吸収性の基板で成長される。基板は能動領域内で生成された光線の一部を吸収するので、素子の効率が低下する。従来の単一異質結晶形の砒化アルミニウム・ガリウム（以下、AlGaAsという）LEDを図20に示してある。p-ドーピングされたAlGaAsのエピタキシャル層10と、n-ドーピングされたAlGaAsのエピタキシャル層12とがp-ドーピングされた砒化ガリウム（以下、GaAsという）吸収性基板14の表面上で成長される。エピタキシャル層10と12の接合部を通る電流の導通によって光線が生成される。しかし、吸収性基板14のエネルギー・ギャップが放射エネルギーよりも小さいので、吸収性基板14の方向に下方に放射され、又は内部反射される光線は吸収される。

【0004】 図21は吸収性の基板16上に二重異質接合形のAlGaAs LEDである。n-ドーピングされたAlGaAsのエピタキシャル層18と、n-ドーピングされたAlGaAsの層20及び22とが吸収性の基板16上で成長される。エピタキシャル層18-22のバンド・ギャップは能動層となるエピタキシャル層20内で光線が生成され、且つ吸収されることなくエピタキシャル層18及び22を通過して進行するように選択される。しかし、光線の吸収は吸収性基板16では生じない。

【0005】 LEDの能動領域の放射エネルギーよりも大きいエネルギー・ギャップを有する透明な基板を使用する

ことによって性能の向上を達成できる。透光性基板の効果は下方に放射される、又は下方に向かう光線の吸収を防止することにある。光線は吸収されずに、透光性基板を透過し、底部の金属粘着物及び反射性キャップから反射される。反射光線はその後、チップの頂部又はエッジから放射され、その結果、LEDの効率が大幅に高まる。

【0006】 透光性基板を有するLEDには幾つかの製造技術がある。第1の技術は透光性基板上でp-n接合をエピタキシャル成長させることである。しかし、この技術の問題点はLEDエピタキシャル層の格子定数によっては許容できる格子整合の達成が困難である点である。第2の技術は後に除去される吸収性基板上でLEDエピタキシャル層を成長させることである。例えば、図3ではn-ドーピングされた透光性基板24と、p-ドーピングされたエピタキシャル層26及び28を吸収性基板（図示せず）上でエピタキシャル成長させることができる。透光性「基板」24は格子整合性の吸収性の基板上で75μm以上の厚い、透光性且つ導電性のエピタキシャル層を成長させることによって製造される。次に別の層であるエピタキシャル層26と28がエピタキシャルの透光性「基板」24上で成長され、吸収性基板は除去される。あるいは、より厚い透光性「基板」24よりも先により薄いエピタキシャル層26及び28を成長させてもよい。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 透光性基板を有するLEDの上記の製造技術には生来の欠点がある。第1に、「厚い」、透光性且つ導電性「基板」をエピタキシャル成長させることは、一定の半導体材料用にある種の成長技術を利用する場合、実際的ではないか、又は不可能でさえある。第2に、それが可能な場合でも、「厚い」エピタキシャル層は長い成長時間を要し、このようなLEDの製造量が限定される。第3に、吸収性基板を除去した後には生ずるLED層は例えば約3-6ミルと比較的薄い。薄いウェーハは破壊せずに取り扱うことが難しく、製造が一層困難になる。更に、ウェーハが薄いことによって、ウェーハをLEDパッケージ内に装着する際に困難が生ずる。ウェーハを破壊し、素子の底部に接触させるために代表的には銀を被覆したエポキシが使用される。エポキシは薄いウェーハのエッジを超えて流出することがあり、それによってダイオード（LED）が短絡する原因になる。更に、薄いウェーハは少なくとも10ミルの「厚い」基板上で成長される図20及び図21の装置ほどには機械的に頑強ではない。このような「薄い」LEDはエポキシ・ランプに装着する際に装置が故障する確率が大きくなる。このように、この第2の技術を採用した場合は透明層は実際の結晶成長プロセスのためには「厚すぎ」、装置の利用に介しては「薄すぎる」ので、矛盾する厚さの問題がある。

(3)

特開平6-302857

【0008】その結果、吸収性基板と、透光性基板の選択に関しては妥協が介在する。成長技術及び製造技術によって、吸収性基板を有するLEDは透光性基板のLEDよりも優れた機械特性を備えることができるが、吸収性基板は一般に効率が悪い。透光性基板を使用すれば効率を高めることができる。しかし、エピタキシャル層が異なる格子定数を有する透光性基板上で成長される場合は、格子の不整合によって困難が生ずることがある。更に、「厚い」透光性「基板」がエピタキシャル成長される場合は矛盾する厚さの問題に遭遇することがある。

【0009】吸収性層又は透光性層の影響は標準型のエピタキシャル層と吸収性層との間にブラッグ・リフレクタ(Bragg reflector)層を成長させることによって最小限に抑制できる。ブラッグ・リフレクタは吸収性層の方向に放射又は内部反射された光線を反射するので、効率の向上は達成される。しかし、ブラッグ・リフレクタは直角に近い入射光線だけを反射するので、向上は透光性基板を使用した技術と比較して限定される。大きく直角とは異なる入射光線は反射せず、基板へと通過し、そこで吸収される。更に、ブラッグ・リフレクタを有するLEDは、代表的には厚さが100オングストロームの多くの薄いエピタキシャル層を繰り返し成長させることが必要であるので、製造が一層困難である。

【0010】本発明の目的は少なくとも8ミルの「厚い」基板の所望の機械的特性と、透光性基板のLEDの光学特性とを有するLEDの形成方法を提案することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】上記の目的は、LED層の成長のために最適な一時的成長基板を使用するが、この基板のエピタキシャル成長を必要とせずに性能が向上された基板が得られる方法によって達成された。好適な実施例では、性能向上基板はウェーハ・ボンディング技術を使用してLED層に接合される透明部材である。透明層はLED層のエピタキシャル成長が終了するまではLED層に接合されないで、透光性基板とエピタキシャル層との格子整合は問題ではない。

【0012】一時的成長基板は所望の機械特性を有するLED層の製造と適応性がある材料から成っている。例えば、高品質の結晶成長を達成し、格子の整合性を最適化するために、標準型の吸収性基板材料を使用できる。次に液相エピタキシ、気相エピタキシ、金属有機化学蒸着及び／又は分子ビーム・エピタキシを含む一つ、又は複数の多様な方法を利用してLED層が成長される。LED構造を生成するLED層は発光能動層と、上下の密封層と、電流拡散及び光放射層と、単数又は複数の緩衝層とから成るものでよいが、これに限定されるものではない。

【0013】LED構造の成長に続いて、吸収性の一時的成長基板は高品質のエピタキシャル層を形成できると

いう目的を完了する。成長基板は除去することが好ましいが、それは吸収性成長基板はLED構造の放射エネルギーより小さいが、それと等しいエネルギー・ギャップを有しているからである。エネルギー・ギャップと装置の放射エネルギーとの間のような関係は装置の効率を著しく限定する。一時的成長基板を除去する方法は限定的なものではなく、別な方法には化学エッチング、ラップ研磨/研削、反応性イオン・エッチング及びイオン磨砕が含まれる。成長基板の除去には更に、吸収性の基板と接触する層の一部又は全部を除去することも含まれる。

【0014】次に第2基板がLED構造にウェーハ・ボンディングされる。好適な実施例では、第2のウェーハが導電性であり、透光性である。吸収性基板と対照的に、透光性基板は性能向上層である。ウェーハ・ボンディングはLED構造の最上又は最下層で行うことができる。従来は、LED装置は素子のp-n接合に適宜にバイアスを加えるために対向端に電極を備えているので、透光性基板と成長層との境界面の抵抗率を最小限にすることが重要である。所望の抵抗特性の達成を促進するためにインジウムを含む成分を使用することが提案されている。In含有成分の他に、表面移動度が高く、拡散性が高く、及び／又は物質移動特性が優れたその他の成分(例えばHg含有、Cd含有およびZn含有成分)を固体ウェーハ・ボンディングの用途で使用すれば有利である。

【0015】

【作用】前述の方法を採用する際の関心事の一つは、一時的成長基板の除去の後は、残りのLED構造が例えば10μm未満と極度に薄く、従って壊れやすく、処理し難いことである。第2の実施例では、一時的成長基板は第2の基板をLED構造の最上層に取り付けた後で初めて除去される。第2基板をエピタキシャル成長させるのではなくウェーハ・ボンディングすることによって例えば8ミル又はそれ以上の厚い基板を取り付けることが可能になる。この第2基板は透明なものでよく、光学的な放出及び電流拡散のための性能向上層として役立ち、及び／又は成長基板を除去し、成長基板がそこから除去されるLED構造の側面で透光性基板の第2のウェーハ・ボンディングを実行する工程の間、機械的な安定性を向上させるための手段としてだけ役立つ。機械的安定性だけが必要である場合は、この第2の基板を第2のウェーハ・ボンディング工程を実施した後に引き続いて除去してもよい。

【0016】ウェーハ・ボンディング技術を採用する最も明らかな用途は光吸収性基板が除去され、透光性基板と置き換えられる用途であるが、これに限定されるものではない。一時的成長基板は電流拡散能力を制限する導電性が低い透光性の基板でよい。このような基板は究極的にはLEDの効率を制限するであろう。そこで、導電性がより高い透光性の基板と置き換えるために透明な一

(5)

特開平 6-302857

【0026】成長基板30の真上のLED層32はn-ドーピングされた緩衝層であるが、成長基板(30)と結合された第2側面ともなる。緩衝層の上方ではn-ドーピングされた下部のAlGaInP密封層が成長される。下部の密封層のLED層34の厚さは例えば800ナノメートルである。

【0027】AlGaInPの能動層となるLED層36は厚さが例えば500ナノメートルまで成長される。次にp-ドーピングされたAlGaInPの上部密封層となるとともに、第1側面ともなるLED層38の模範的な厚さが例えば800ナノメートルである。電流の拡散を促進することによって、LED構造の性能を向上するために、透明で、LED層34、36及び38よりも導電性が高いウィンドウ層をオプションとして上部密封層となるLED層38の上で成長させてもよい。このようなウィンドウ層はフレッチャー(Fletcher)他の米国特許明細書第5,006,718号に記載されている。

【0028】LED層32-38内ではある程度の光吸収性及び電気抵抗率の誤差が許容される。それはこれらの層が十分に薄く、最適な特性を達成するために素子の性能を著しく没害しなくてもよいからである。しかし、光吸収性の一時的成長基板30は明確に性能に影響を及ぼす。さて、図2を参照すると、成長基板は既に除去され、成長層であるLED層32-38によって形成されたLED構造が残されている。成長基板の除去は、化学エッチング、ラップ研磨/研磨、反応性イオン・エッチング及びイオン磨砕を含むそれらの組み合わせの方法で達成できる。後に詳述するように、成長基板を除去する方法は除去した後で磨砕で平坦な表面が現れる限りは限定的なものではない。成長基板に加えて、緩衝層であるLED層32の全部、又は一部を除去し、下部の密封層であるLED層34の一部を除去することができる。

【0029】一時成長基板を除去した後、性能向上基板が図2に示したLED構造40の最下層のLED層32又は最上層のLED層38の何れかに接合される。接合されるべきウェーハの位置はLED構造40、及び成長層32-38及び/又は接合される基板の電気的及び光学的特性に左右される。ウェーハ・ボンディング技術が採用される。ウェーハ・ボンディングによってLEDに性能増強基板を付与する別の方法と比較して多くの利点が見られる。

【0030】図3は透明層として使用され、また永久基板でもある導電性、透光性基板42が緩衝層であるLED層32にウェーハ接合された実施例を示している。ウェーハ・ボンディングには透光性基板を成長させる必要なくともこれを得られるという利点をもたらす。好ましくはウェーハ接合された導電性、透光性基板42は8ミルを超える厚さを有している。従来の技術を使用してこれに匹敵する厚さを有する基板を成長させることは困難であるか、不可能であり、可能であるにしても極めて長

時間を要するであろう。LED構造40の比較的薄い層であるLED層32-38だけを成長させればよいので、エピタキシャル成長に要する時間を劇的に短縮でき、それによって処理量を最大限にすることができる。更に、ウェーハ・ボンディング工程によってエピタキシャル成長される透光性基板と比較して機械的特性が増強された厚い装置が得られる。その結果生産されるLED装置は取扱いが一層容易になり、破壊しにくくなるので、製造がより簡単になり、装置の生産量が増大する。ウェーハ・ボンディングは更に装置の底部からp-n接合部を突出するために利用してもよく、それによって従来のように装置を導電性銀含有エポキシに実装する際に装置が短絡回路とする可能性が軽減される。

【0031】さて図4を参照すると、製造工程の残りにては標準型のLED技術が含まれる。電極44が例えば蒸着によって上部密封層であるLED層38上に形成される。電極を形成する代替的な材料は金-亜鉛合金である。第2電極46は導電性、透光性基板42上に形成される。この場合も蒸着が用いられるが、それに限定されるものではない。代表的な材料は金-ゲルマニウム合金である。

【0032】場合によってはウェーハ・ボンディングと適応化するために上記の工程を修正することが望ましいか、又は必要でさえあることがある。例えば、図5では、S10基板の永久基板でもある第2基板48が図1の構造にウェーハ接合されている。すなわち、第2基板は一時的成長基板30を除去する前にウェーハ接合される。第2基板48は8ミルを超える「厚い」層であることが好ましい。成長基板30を除去する前にウェーハ接合することによって、エピタキシャル層のLED層32-38が基板によって支持されない時間がなくなるので、装置の機械的な安定性は大幅に向上するであろう。別の選択として、ウェーハ・ボンディングの前に緩衝層を第2基板48上にエピタキシャル成長させてもよい。このようなエピタキシャル緩衝層は緩衝層であるLED層32の底部で成長基板30と置き換えられる層と共に使用してもよい。

【0033】別の実施例では、図1の装置は透光性、又は吸収性の成長基板30上で成長されるLED層32-38を有する従来形の構造のものでよい。その場合は図5のウェーハ接合層による第2基板48は、フレッチャー(Fletcher)他の米国特許明細書第5,006,718号を参照して前述した電流拡散ウィンドウ層のような厚い、導電性、透光性の層となる。更に、最上層の第2基板48を接合した後、光線放出及び/又は電流拡散特性を向上させる理由から、元の成長基板30を除去し、別の性能向上基板を残りの構造の底部にウェーハ接合することも可能である。

【0034】更に、図1の素子は導電率が低く、装置の電流拡散力が限定される従来形の透光性層の成長基板3

(6)

特開平5-302857

0を有しているものでもよい。この場合は、導電率がより高い透光性基板をウェーハ接合することが望ましい。導電率が高まると、装置の性能が向上しよう。置き換えの透光性基板が導電率の低い露出したLED層にウェーハ接合される。導電率がより高い置き換えの透光性基板を、導電率が低い透光性層の除去の前又は後にLED構造にウェーハ接合することができよう。

【0036】同様に、吸収性の一時的成長基板を導電率がより高い吸収性基板と置き換えてもよい。吸収性層を取り付けるためにウェーハ・ボンディングを利用することは好適な本実施例ではないが、このようなウェーハ・ボンディングでもLED素子の性能を同様に向上させるであろう。

【0037】さて図6を参照すると、ウェーハ・ボンディングは図1又は図3の何れかの構造を不活性化するためにも利用できる。多くのAl含有III-V半導体は、このような半導体が加水分解により劣化し易いので、湿気のある雰囲気では不安定である。このような劣化によって相当の厚さのAl含有III-Vエピタキシャル層のLED層30-38を含むLEDに信頼性の点で問題が生ずることがある。例えば、劣化は湿気がある高温下で使用中にAl含有率が高い上部の密封層であるLED層38の酸化に起因する場合がある。Al含有層の大部分をAl成分の含有率が低い厚い、透光性、導電性のウェーハ・ボンディング層と置き換えれば、劣化は防止できる。例えば、ウェーハ・ボンディング層50はGaPでよい。

【0037】図3を再び参照すると、導電性、透光性基板42とLED構造40との間の所望の電気的接続は金属化の実施によって保証することができる。例えば、ウェーハ接合される導電性、透光性基板42の上面に薄い接点領域を形成することができる。対応する接点領域をLED構造の最下層のLED層32に形成することができる。厚さが1000オングストローム未満の接点が良い。適正な電気的接点を確保するためには接点のパターンは充分に大きいことが必要であるものの、接点が占める総面積は、LED構造と導電性、透光性基板42との境界面が透光性基板への、又、透光性基板からの光線の透過を可能にするのに充分小さいことが必要である。接点は合金でも、非合金でもよい。そこで基板の表面が最下層のLED層32の表面と接触され、装置は温度を上昇して熱処理される。熱処理によって金属化されない領域でのウェーハ・ボンディングが達成され、金属化された接点での接合がなされる。

【0038】半導体-ガラス接合において、半導体-半導体接合と比較して優れた接合強度が認められた。半導体-半導体接合と比較して同様のことが、半導体-SiO₂接合の場合にも認められる。このように、機械的な完全性の観点から、半導体-ガラス-半導体の接合層、又は半導体-SiO₂-半導体の接合層を製造すること

によって透光性基板のLEDを形成することが望ましいだろう。図7を参照すると、ガラス又はSiO₂、又はその他の酸化物の層52を導電性、透光性基板54上に形成することができる。次に層52がパターン形成されて、直前に述べた実施例の場合のように接点金属化領域56が付与される。あるいは、又はそれに加えて、LED構造40の最下層のLED層32上に酸化物及び/又は接点金属化領域58にパターン形成してもよい。この場合も、接点は良好な電気的接触用に充分な面積を付与し、同時に境界面を依然として大幅に透光性にするようにパターン形成される必要がある。次に層52の表面が緩衝層であるLED層32の表面と接触され、処理によって層の間のウェーハ接合が形成される。熱処理によって材料相互間の接合強度が増強される。

【0039】さて図8を参照すると、前述のLED構造40はミラー60にウェーハ接合することができる。ミラー60はそこで下方に放射された光線、又は先に反射された内部光線を反射する。反射によって装置の光線出力が高められる。ミラー60は基板62によって好適に支持される。光線は基板に到達する前に反射されるので、基板の光学特性は関係がない。

【0040】ミラー60と基板62はLED構造40にバイアスを加えるために電極を基板に接合できるように、導電性材料から成る必要がある。更にミラーはエピタキシャル成長又は溶着されたブラッグ・リフレクタから成っているものでもよいことに留意されたい。基板62を形成するためにシリコン、GaAs又は同様の他の材料を使用できる。装置が高温下で、又は高電流下で動作される場合、これらの材料の幾つか、例えばSiは熱伝導率が比較的高いので、これらの材料によって装置を更に向上させることができる。

【0041】ウェーハ・ボンディング工程を利用して積層LED装置を形成することもできる。このような素子は図9に示されている。境界面が装置を通して高い導電率が保持されるような境界面である場合は、複数のLED構造40と64とを互いに接合でき、且つ(又は)別の層と接合できる。上部のLED構造40のLED層34と38のドーピングの形式は下部のLED構造64の層70及び66のそれぞれのドーピングの形式と対応する。従って、二つのLED構造40と64とは同じ極性で配置されている。更に、ウェーハ接合される表面は極めて重くドーピングされるように準備される必要がある。このようにして、構造が互いに接合される際に、LED構造と逆の極性を有する重くドーピングされたトンネル接合部72が形成される。あるいは、トンネル接合部は、この接合部の露出表面にウェーハ・ボンディングを行いつつ、LED構造の一部としてエピタキシャル成長させてもよい。

【0042】図9の装置は個々のLED構造40及び64が順方向にバイアスされるように、上部電極74に電

(7)

特開平 6-302857

圧を印加し、下部電極 76 に電圧を印加することによって動作される。下部電極は導電性、透光性基板 78 上のパターン化された金属化層である。積層装置の順方向バイアスは通くドーピングされたトンネル接合部 72 に逆バイアスを加え、それによってトンネル接合部を導電性にする。このようにして、光線出力と効率を高めるために任意の数の LED を互いに積層することができる。LED 構造 40 及び 84 の積層から成る LED 装置は、それが互いに積層されていない場合の個々の LED 構造の電圧の総計で動作する。能動層である LED 層 38 と能動層 68 とが同じ放射エネルギーを有することは決定的に重要ではない。しかし、導電性、透光性基板 78 は個々の LED 構造の放出エネルギーよりも大きいエネルギー・ギャップを有していることが好ましい。導電性の形式の全てが反転された場合も積層を形成できることに留意されたい。

【0043】LED の形成に際して任意の数の基板をウェーハ接合することができる。好適な実施例では、ウェーハ結合層は厚さが 1 ミルを超える半導体である。許容できる材料には Si, Ge, AlP, AlSb, GaN, AlN, GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs, InSb, ZnS, ZnSe, CdSe, CdTe, SiC, 又は上記の合金の任意の組合せが含まれる。ウェーハ接合基板は市販のものでもよく、又は、市販の基板にエピタキシャル成長層を付加したものでもよい。エピタキシャル成長層を付加する理由は例えば基板の接合強度を高めたり、ウェーハ接合の境界面の導電率を高めるためである。ウェーハ接合基板は単独で、一時的成長基板から除去された前述の材料の厚い、すなわち 1 ミル以上のエピタキシャル層であることもできる。更に、ウェーハ接合層は一時的成長基板上に形成された、例えば 2 μm のより薄いエピタキシャル層であってもよい。その後、このような層がウェーハ接合され、引き続いてこの成長基板が除去される。

【0044】図 10 はパターン形成された第 1 の層としての半導体ウェーハ 126 が、上部の密封層 130 と、能動層 132 と、下部の密封層 134 とから成る LED 構造 128 にウェーハ接合される実施例を示している。LED 構造は基板 136 上で成長させるか、又は、基板 136 にウェーハ接合されることができる。パターン形成された半導体ウェーハ 126 は図 5 を参照して説明したような電流拡散ウインドウでよいが、これに限定されるものではない。パターン形成された半導体ウェーハ 126 は第 1 の表面としての下部表面 138 が窪み 140 を形成するためにエッチングされる。窪みを設けることによってパターン形成された半導体ウェーハが LED 構造と接合される際に電気的特性と光学的特性の双方が変化する。

【0045】図 11 では、パターン形成された半導体ウェーハ 126 が LED 構造 128 の上部の密封層 130

にウェーハ接合されている。次に電極 142 及び 144 A がパターン形成された半導体ウェーハ 126 の上部表面と基板 136 の下部表面上に形成される。パターン化されたウェーハ内の窪み 140 は空洞もしくは空隙を形成する。電極 142 に電圧を印加することによって LED 構造 128 に電流が導通するが、図 11 の電流の流れの矢印が示すように、空洞の真下の領域には電流は流れない。

【0046】電極の領域は一般に吸収性の領域である。その結果、図 11 に示したような限定された電流の流れによって LED 装置の効率が向上し、電流導通経路を選択する複雑ではない方法が得られる。

【0047】ディスプレイ及びスポット・エミッタのようなその他の LED 装置も限定された電流の流れによって利点を得られる。図 12 は基板 146 上に LED 構造 144 を備えたスポット・エミッタ 142 を示している。窪み 148 と 150 はウェーハ・ボンディング層 152 内に形成されている。LED 構造とウェーハ・ボンディング層との境界面の空洞は、電極 154 及び 156 から境界面への電流の流れを限定する機能を果たす。窪みが境界面での電気的接触領域を限定するので、限定された電流導通経路によって窪み 148 と 150 との間に電流注入領域が得られる。スポット・エミッタ 142 を光ファイバ素子に結合するような用例では、中央領域での電流の流通と光線出力が望ましい。好適な実施例では、窪み 148 と 150 は単一の環状空洞の異なる部分であり、この空洞内では内径が中央の電流注入領域を形成する。

【0048】ウェーハ接合される半導体ウェーハのパターン形成は、LED 層から放射された光線を戦略的に再配向することにも有利に利用できる。光線の再配向は装置の幾何的形狀や、用途や取付け方法によって異なる。その一例が図 13 に示されている。LED 層 156 A は上層 158 と下層 160 との間に挟持されている。外部層 162 と 164 は反対側でウェーハ接合される。電流が非接合領域に拡散できるように、非接合領域 166, 168 及び 170 は電極 172 から十分に離れた部位に形成される。しかし、そうしなければ電極によって吸収されてしまう光線を再配向するために、空洞は電極には十分に近くにある。このようにして光線放出の向上を実現可能である。

【0049】電極 172 から LED 層 156 A への電流の導通は非接合領域 166, 168 及び 170 によってほとんど影響されないが、LED 層からの光線に影響される。光線の再配向は非接合領域 166, 168, 170 と隣接する層との屈折率の差の結果として生ずるものである。周囲の半導体の屈折率は約 3 でよく、一方空洞内の屈折率は約 1 である。非接合領域での正確な屈折率は半導体ウェーハの接合方法によって左右される。代表的には、接合は H_2 又は PH_3 のような気体環境で行わ

(B)

特開平6-302857

れる。従って、空洞には気体が充填されることになる。このような気体は標準気圧及び温度では極めて1に近い屈折率を有している。半導体の屈折率は最適には光線が空洞内で閉込められないように空洞の屈折率よりも大きい、これは厳密なものではない。

【0050】LED用にパターン形成された半導体ウェーハの接合を行う別の方法は、LED層にパターン形成された、又はされない基板に接合する前にLED層の一つにパターン形成する方法である。図14では、パターン形成されたLED層174は窪み176を設けている。パターン形成されたLED層174は当初からエピタキシャル成長されたものでもよく、又は基板180下に位置するLED層178にウェーハ接合されたものでもよい。窪み176の形成に引き続いて、第2基板182がパターン形成されたLED層の上表面にウェーハ接合される。あるいは、LED層174及び/又は第2基板182にパターン形成してもよい。更に、少なくとも一方にパターン形成された二つの層を別個にウェーハ接合し、次に二つの層をLEDエピタキシャル層にウェーハ接合することも可能である。

【0051】再度図10を参照すると、窪み140は標準のエッチング技術を利用して半導体ウェーハ126に形成できる。接合されるウェーハの表面にパターン形成するために、技術上周知の別の方法も利用できる。単なる例示として挙げると、別の方法には逆バイアスされた埋設p-n接合部を形成するための選択的拡散又はイオン注入や、選択的なパターンで絶縁酸化層を成長又は蒸着する方法や、利用できる種々の方法の任意の組合せ等が含まれる。酸化層に関しては、殆どの酸化物の屈折率は約1.6であり、これはエッチングとウェーハ・ボンディングによって形成される前述の空洞と同様に光線を再配向するに充分な屈折率である。

【0052】パターン形成されたウェーハ・ボンディングの試験がn-GaP基板を使用して行われた。パターン化されたn-GaP基板が後述する技術を用いてパターン形成されないn-GaP基板に結合された。パターン形成された基板は直径が約175 μ mで深さが約15 μ mの環状窪みをエッチングすることによって形成された。窪みは125 μ mだけ間隔を隔てられた。このような寸法で基板のパターン形成は容易に達成でき、接合は基板を剪断できるのに充分な機械的強度を有していた。約40 μ mであるより小さい窪みも実験された。10 μ m未満の寸法にまで縮小範囲を広げることができ、微細なスケールの電流限定及び光線拡散能力が得られよう。パターン形成されたウェーハが接合された領域間に電流の導通を可能にし、同時に接合されない空洞での電流の流れを防止するように、後述する技術を利用してn-形又はp-形の何れかのユニポーラ接合用の、電気抵抗が低いGaP-GaP接合も達成された。

【0053】実際への適用

図15は一对のウェーハ80のウェーハ接合を達成するための公知の装置を示している。一对のウェーハは第1の黒鉛部材84と対面している。第1黒鉛部材内の溝付き領域82の面積は0.5インチ×0.8インチである。第2黒鉛部材86は第1黒鉛部材から突設した位置合わせピン90を受容する位置に穴88を備えている。互いに接合される一对のウェーハ80の厚さをランツナーランで変化させるために、黒鉛シム(図示せず)を溝付き領域82内に配設することができる。

【0054】第1と第2黒鉛部材84及び86を位置合わせピン90を利用して接合した後、アセンブリが密着嵌め石英管92内に挿入され、この石英管は次に開管形加熱炉に装入される。1.0リッター/分の流速のH₂雰囲気中で温度が850-1000℃まで上昇される。温度周期は所望の温度へ傾斜させる周期であり、その後、5秒ないし1時間埋熱処理される。次に冷却周期が続く。

【0055】加熱中、一对のウェーハ80が圧縮される。圧縮力は石英管92の熱膨張係数(6.5×10⁻⁷/℃)と、第1と第2黒鉛部材84及び86の熱膨張係数(8.4×10⁻⁶/℃)との差によって生ずる。更に、ウェーハ80の熱膨張係数(例えばGaPの場合は5.8×10⁻⁶/℃)は相当であるので、圧縮力を更に促進する。上昇した温度で、111-V半導体ウェーハがやや塑性になる。その結果、ウェーハ表面は圧縮されると互いに順応してウェーハ表面のムラが補正されることに寄与する。

【0056】図15のウェーハ・ボンディング装置に装置する前に、ウェーハ80は洗浄にしてウェーハ表面から汚れや酸化物を除去しなければならない。有機汚染物は一般に脱脂技術によって除去される。材料がIn_xGa_{1-x}P及びGaPである場合は、酸化物は代表的にはNH₄OHでエッチングされることによって除去される。エッチングの後、ウェーハから残余のNH₄OHを除去するためにウェーハは直ちにメタノール中に置かれる。接合される表面はサンプルがメタノール中にある間、接触状態にされている。

【0057】次に接触しているウェーハ80からメタノールが除去される。メタノールは速やかに蒸発し、ウェーハ80はファンデルワース力によって結合状態に留められる。しかし、ファン・デル・ワースによる接合には一般に充分な機械的強度がなく、一般に前述のようなLED装置の製造で使用されるのに充分な導電性が得られない。従って、更に別の固体接合が必要である。そこで図15のウェーハ・ボンディング装置が使用される。

【0058】下記の実験の場合、ウェーハはGaP:S(n=5×10¹⁷cm⁻³)の基板[(100)+(110)の方向に2°、又は(100)+(110)の方向に10°]と、(GaAs上で成長せしめた厚さ2ミルの気相エピタキシャルGaPから作成された)GaP:Zn

(9)

特開平6-302857

($p=2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)「疑似基板」から成っている。 GaAs:Te ($n=5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$) 上で金属有機化学蒸着 (MOCVD) によって成長させた $1 \mu\text{m}$ の $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P:Te}$ ($n=1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)、及び MOCVD によって GaAs 上で成長させた $\text{In}_{0.5}(\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{P}$ 二重異型構造の LED とから成る層も用いられた。 GaAs 基板は (110) の方向に (100) + 2° の配向であった。固体ウェーハ・ボンディングの後、露出表面の熱損傷は一般に $\text{HCl}:\text{HNO}_3:\text{H}_2\text{O}$ (1:1:1) 中でのエッチングによって除去される。次にウェーハは n -形接点用に AuGe で金属化され、及び/又は p -形接点用に AuZn で金属化され、合金され、チップへと切断される。

【0059】二つのウェーハ・ボンディング層のウェーハ80の境界面で所望の電気抵抗特性を達成するように上記の工程を実行する上で考慮すべき重要な点は、接触前のウェーハの表面の処理であることが判明した。前述したように、好適な工程にはウェーハを NH_4OH でエッチングして表面処理し、その後、ウェーハ80がメタノール溶液中浸漬中に表面を互いに接触して接合する工程が含まれる。これらの二つの工程に含まれる処理の後には接合されるウェーハが、 HF :脱イオン水 (1:10) でエッチングし、次に脱イオン水で濯ぎ、 N_2 で乾燥させた別の処理工程の後には接合されたウェーハと比較された。双方の場合とも、接合されたウェーハは n -形 GaP 基板と、(GaAs:Te 上の) n -形 $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ から成るものであった。別の表面処理工程の後には、ウェーハは図15のウェーハ・ボンディング装置内に装荷された。ウェーハは同様に 1000°C で1時間熱処理された。 NH_4OH -メタノールで処理されたウェーハの場合、電流-電圧特性によって明確に、比較的抵抗の抵抗接合が示された。 HF :脱イオン水でのエッチングにより処理されたウェーハは、接合されたウェーハの境界面で「障壁」が形成されたかのように非抵抗特性を呈した。このような非抵抗特性は一般に一つのウェーハ接合された基板から別のウェーハ接合された基板へと電流が導通されるべき用途には許容されない。

【0060】 NH_4OH -メタノールによる表面処理は n -形 InGaP を n -形 GaP に接合する場合、現在のところ所望の電気的抵抗特性を達成する好適な処理であるものと考えられる。 NH_4OH でエッチングし、メタノールで濯ぎ、接触前に N_2 で乾燥させるような別の表面処理では非抵抗特性が生じる。しかし、(n -形 GaAs:Te 上の) n -形 $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ を (GaAs:Te 上の) n -形 $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ と接合するために同じ処理を行った場合、所望の抵抗結合特性が生じた。この差異はこの表面処理が $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ には充分であるが、 GaP から酸化物を全て除去することはできないことによるであろう。この差異の原因として考えられる別の説明としては、 In 含有成分の場合には

接合特性が向上したことが挙げられる。

【0061】(a) n -形の $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ に接合された n -形の $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ からなく固相接合されたウェーハと、(b) n -形の GaP に接合された n -形の $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ から成る固相接合されたウェーハとの比較がなされた。双方の組のウェーハとも所望の電気的抵抗特性を有するウェーハ結合が得られた。しかし、(a) ユニポーラの n -形の $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}/\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ の接合は、(b) ユニポーラの単極の n -形の $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}/\text{GaP}$ 接合と比較して境界面で著しく低い抵抗を呈した。(a) の場合は抵抗は約1.5オームであり、一方、(b) の場合は抵抗は約6オームであった。(20×20ミルのサイズ) あるいは、抵抗がより低い $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}/\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ の接合は、 1000°C で達成される $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}/\text{GaP}$ の接合と比較して、約 976°C のより低温でウェーハ領域全体に亘って形成可能である。

【0062】実験の結果は、LEDの製造で用いられる固体ウェーハ・ボンディングには In 含有成分が望ましいことを示している。その理由として可能な一つの説明としては、半導体ウェーハの接合工程の間、材料がせん断応力、蒸発-凝結、及び物質移動によって材料が遷移可能であることが挙げられる。 In 含有成分に認められる接合の増強は、 Ga 原子と比較して In 原子の表面移動度が高く、又は、 GaP と比較して $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{P}$ の物質移動特性が優れている結果として望ましいものである。更に、 $\text{AlGaAs-GaAs-InGaAs}$ 構造では拡散度が比較的高いことが知られている。同様に、 In は固相ウェーハ・ボンディング工程中に拡散、又は GaP と合金して、接合された境界面の周辺で $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{P}$ ($x < 0.5$) 合金を形成することができる。

【0063】 In 含有成分に加えて、同様の特性、すなわち原子の表面移動度が高いこと、及び/又は物質移動特性の向上という特性を有する別の III-V 、又は I-IV 成分も固体ウェーハ・ボンディング用に有利に利用できる。従って、 Hg 含有、 Cd 含有、及び Zn 含有成分はこのような用途での主要な候補である。

【0064】所望の電気的抵抗特性を備えた固体ウェーハ接合を形成する別の重要なパラメータは、図15の装置内でウェーハ80を熱処理する場合の温度分布である。図16は二つの異なる温度分布を示している。上部の温度分布では、 1000°C までの「迅速な」傾斜 (ramp) が示され、一方、下部の温度分布は 1000°C までの「緩速な」傾斜が示されている。何れの場合も、 1000°C まで傾斜した後1時間の熱処理が行われる。同様の冷却用温度分布が示されている。

【0065】下部の「緩速な」傾斜によって一般により低い温度で、又、実質的により大きい面積に亘る抵抗結合が生ずる。この現象は高温遷昇の一部の期間中、圧縮

(10)

特開平 8-302857

されない接合表面により生ずるものである。それによってウェーハ・ボンディングに先立ち、ある程度の表面分解、又は熱による酸化物剥脱が可能になる。更に、このような差異は「傾斜」の傾斜による有効な熱処理が長いに起因するものであろう。しかし、この作用はn-形とp-形のウェーハの接合のみに認められるものである。このような依存性はp-形とp-形のウェーハの接合では認められなかった。

【0066】n-形のウェーハよりもp-形のウェーハ相互間の抵抗接合の方が容易であることはある程度明らかである。p-GaPとp-GaPの、又、n-GaPとn-GaPのウェーハ・ボンディングが実行された。双方の場合とも、接合は1時間に亘って1000℃で行われた。n-形とp-形の双方の接合ともサンプルの全領域に亘る抵抗接合が生じた。しかし、接合抵抗は12×12ミルのチップの場合、GaP/GaP n-形ユニポーラ・ウェーハ接合の場合（約5オーム）よりも、GaP/GaP p-形ユニポーラ・ウェーハ接合の場合（0.9オーム未満）の方が大幅に低かった。n-形ドーパントと比較してp-形ドーパントの拡散率が高いことによってp-形サンプル相互間の抵抗接合を形成し易いことになる。

【0067】吸収性GaAs構造を除去し、透光性GaP基板をIn_{0.5}(Al_xGa_{1-x})_{0.5}P LEDに固体ウェーハ接合することによって、元の吸収性GaAs成長基板を残したままの同じLED基板と比較して約2倍という光線出力の顕著な向上が達成された。

【0068】図15のウェーハ・ボンディング装置は所望の結果を達成するものの、この装置では残念ながら温度に関わりなく圧縮力を加えることができない。すなわち、この装置は材料の熱膨張の結果として圧縮力を生ずるので、圧力と温度を別個に制御することができない。その結果、図17及び図18の反応炉94が開発された。図17は反応炉94の上断面を示している。反応炉は一对のウェーハを圧縮するための二つの黒鉛部材96及び98を備えている。一つの黒鉛部材96の位置合わせピン100が別の黒鉛部材98のノッチ内に受容されている。

【0069】黒鉛部材96及び98は火熱炉管102内に配置されている。後方の黒鉛部材96は黒鉛部材の弧状開口部108内に軸106を受容することによって加熱炉管102に対して固定位置にある。前方の黒鉛部材98は加熱炉管102内に移動可能である。黒鉛部材98の開口部112内に受容された軸104に空気圧ピストンが取り付けられている。空気圧ピストンは黒鉛部材に、ひいては110の位置にある一对のウェーハに可変圧を加えるために空気圧制御されている。

【0070】図18を参照すると、一对のウェーハ112及び114は最初には分離されている状態が示されている。これと対照的に、図19は二つのウェーハ120が

最初から接触している第1と第2黒鉛部材116及び118を示している。図19の実施例が試験され、予備データは固体ウェーハ・ボンディングを境界面全体に亘って実施できることを示している。温度の調数としての印加圧力の分布はウェーハ120の亀裂と破損を最小限にする上で重要である。亀裂の発生はウェーハが柔軟ではない温度で高圧を加えることに起因することがある。

【0071】ウェーハ112及び114を最初に分離できる図18の実施例は、ウェーハを接合する前にウェーハ表面から酸化物を熱脱離できるので好適である。あるいは、接合されるべき表面をある程度分解することが望ましいこともある。図18の実施例はこのような接合条件を促進するものである。

【0072】別の可能性として、ウェーハ表面から参加物を別個に脱離し、且つ表面をAキャップ又はPキャップで覆ってそれ以上酸化することを防止することがある。キャップを装着されたウェーハはその後、黒鉛部材の間に配置されよう。キャップはウェーハの表面自体を有効に分離するので、キャップを装着されたウェーハが物理的に接触しているか否かは重要ではない。次にキャップを装着されたウェーハは600℃を超える温度に加熱されて、ウェーハのキャップが除去され、接合用に酸化物を含まない表面が残される。次にウェーハは押圧されて接触され、固体ウェーハ・ボンディング用に温度が上昇される。

【0073】更に、接合中にドーパントのガスを図17の火熱炉102を通して流通させ、接合される境界面でのキャリア濃度を高めることができる。適切なドーパント・ガスにはH₂Se、H₂S、DETO及びDMZnが含まれよう。これはp-形接合よりも困難であるとみられるn-形結合にとって特に重要である。

【0074】図17の反応炉94によって図18の装置が必要であるよりも低い温度で抵抗固体ウェーハ・ボンディングの形成が可能である。温度が低いことによってエピタキシャルLED層の層同士の混合が最小限に抑止されよう。より重要である点は、温度が低いことによって装置の層内でのp-n接合部の移動が最小限に抑止されることである。

【0075】LEDの用例のためのウェーハ・ボンディングの更に別の用途には、ウェーハの機械的、熱力学的安定性を向上するために安定性に欠ける半導体層に頑強な半導体ウェーハを接合することがある。一つの特定の用例は、機械応力及び熱応力の双方に関してIII-V、又はIV-IV半導体よりも一般に安定性に欠けるとみられるIII-IV LED構造用の用例である。その結果、LED装置の機械的及び熱力学的安定性の双方又は一方を向上するためにIII-V層に頑強なIII-V半導体又はSiC基板を固体ウェーハ結合することが望ましい。

【0076】以上のように、本発明の各実施例について

(12)

特開平6-302857

イオード構造にウェーハ・ボンディングする；工程とからなる発光ダイオードを積層する方法である。

【0090】15. 前記第1発光ダイオード層(34, 36及び38)は、一時的成長基板(30)上に成長され、さらに一時的成長基板を除去する工程を含む前記14に記載の発光ダイオードを積層する方法である。

【0091】16. ウェーハ・ボンディング工程は、前記第1及び第2発光ダイオード構造は同じ極性を有するように第1及び第2発光ダイオード構造(40及び64)を位置合わせする工程を含む前記14に記載の発光ダイオードを積層する方法である。

【0092】17. 第1及び第2発光ダイオード構造(40及び64)間のトンネル接合部(72)を形成し、トンネル接合部は第1と第2発光ダイオード構造とは反対の極性を有する工程をさらに含む前記14に記載の発光ダイオードを積層する方法である。

【0093】18. 光学的特性と電気的特性の少なくとも一方が第1及び第2の層(130)の境界面に沿って選択的に変化するように第1の層(126)の第1の表面をパターンニングし；及び第1の層の第1の表面を第2の層にウェーハ・ボンディングする；工程とからなる境界面に接合されて隣接した第1と第2の層(126及び130)を含む複数の層を有する発光ダイオードを形成する方法である。

【0094】19. 発光ダイオード層(130, 132, 及び134)をエピタキシャル成長させ、エピタキシャルに成長された発光ダイオード層に所望の電流経路を規定するためにパターンを選択する工程をさらに含む前記18に記載の発光ダイオードを形成する方法である。

【0095】20. 第1の層(126)の第1表面をパターンニングする工程は、第1の表面に沿って窪み(140)を形成するために第1の層から材料を除去する工程を含む前記18に記載の発光ダイオードを形成する方法である。

【0096】21. 電圧を印加するために窪み(140)と位置合わせして電極(142)を形成し、電極は第2の層(130)とは反対側に配置される工程を含む前記18に記載の発光ダイオードを形成する方法である。

【0097】22. 第1の層(126)は、電流拡散ウィンド層を形成するような材料から選択される前記18に記載の発光ダイオードを形成する方法である。

【0098】23. 第1の表面(138)が発光ダイオード構造(128)によって発生される光線用の光反射パターンを形成するようなパターンを選択する工程を含む前記18に記載の発光ダイオードを形成する方法である。

【0099】24. 第1の基板(30)を設け；第1の基板にI-III-VI半導体発光ダイオード構造(40)を設

け；及びI-III-V半導体基板とSiC基板(48)の一つをI-III-V半導体構造にウェーハ・ボンディングすることによってI-III-V半導体構造の安定性を向上する；工程とからなる発光ダイオードの製造方法である。

【0100】

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、所望の機械的特性を有するLED層の製造に適合を有する材料で第1基板を形成し、この第1基板上にLED層を形成してLED構造を形成し、LED層に透光性材料による透明層をウェーハ・ボンディングするようにしたので、第1基板にエピタキシャル成長を要することなく、所望の機械的特性と透光性を有するLEDを短時間に大量に製造することができるとともに、透明層と成長層との境界面の抵抗率を最小限にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による一時的成長基板を有する二重異質接合LED装置の側面図である。

【図2】図1の一時的成長基板を除去したLED構造の側面図である。

【図3】ウェーハ・ボンディング技術を利用して取り付けられた永久基板を有する図2のLED構造の側面図である。

【図4】対向側に電極を有する図3の構造の側面図である。

【図5】ウェーハ・ボンディングによって製造された別のLED構造の側面図である。

【図6】図1の装置にウェーハ接合基板を取り付けた第3の実施例の側面図である。

【図7】図2のLED構造にウェーハ接合基板を取り付けた別の実施例の側面図である。

【図8】ウェーハ・ボンディング技術によってミラーに取り付けた図2のLED構造の側面図である。

【図9】積層されたLED装置の側面図である。

【図10】ウェーハ接合されたパターン形成層を用いるLED装置の側面図である。

【図11】ウェーハ接合されたパターン形成層を用いるLED装置の側面図である。

【図12】ウェーハ接合されたパターン形成層を用いるLED装置の側面図である。

【図13】ウェーハ接合されたパターン形成層を用いるLED装置の側面図である。

【図14】ウェーハ接合されたパターン形成層を用いるLED装置の側面図である。

【図15】本発明の工程を実行するためのウェーハ・ボンディング装置の分解図である。

【図16】図15のウェーハ・ボンディング装置を動作する際の温度分布グラフである。

【図17】本発明の工程を実行するための別の装置の概略図である。

(13)

特開平 6-302857

【図18】図17の装置とともに使用するための黒鉛部材の実施例を示す分解斜視図である。

【図19】図17の装置とともに使用するための黒鉛部材の別の実施例を示す分解斜視図である。

【図20】従来の吸収性基板を有する単一異質接合LED装置の側面図である。

【図21】従来の吸収性基板を有する二重異質接合LED装置の側面図である。

【図22】従来の透光性基板を有する二重異質接合LED装置の側面図である。

【符号の説明】

30 成長基板

32, 34, 36, 38, 156A, 174, 178

発光ダイオード層

40, 64, 128, 144A 発光ダイオード構造

42, 78 導電性、透光性基板

44, 142, 144, 164, 166 電極

46 第2の電極

48, 162 第2基板

50, 152 ウェーハ・ボンディング層

56, 58 接点金属化領域

60 ミラー

62, 136, 146, 180 基板

68, 132 能動層

72 トンネル接合層

74 上部電極

76 下部電極

80, 110, 112, 114, 120 ウェーハ

84, 116 第1黒鉛部材

86, 118 第2黒鉛部材

92 石英管

94 反応炉

96, 98 黒鉛部材

102 加熱炉管

126 半導体ウェーハ

134 下部の密封層

138 下部表面

140, 148, 150 蓋み

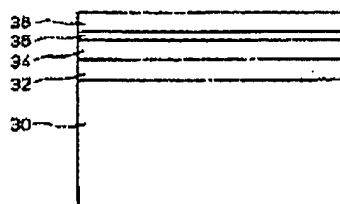
158 上層

160 下層

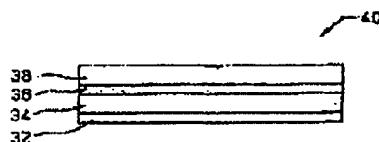
162, 164 外部層

166, 168, 170, 172 電極

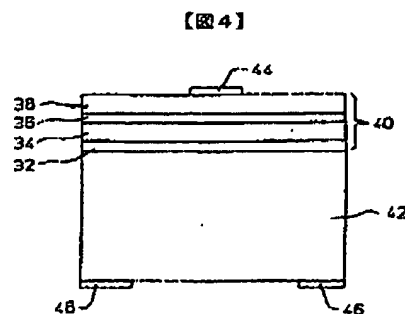
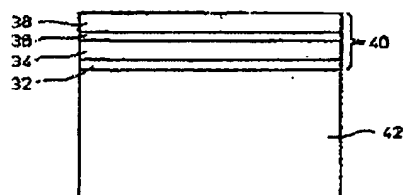
【図1】



【図2】



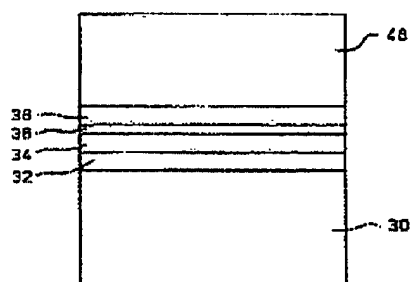
【図3】



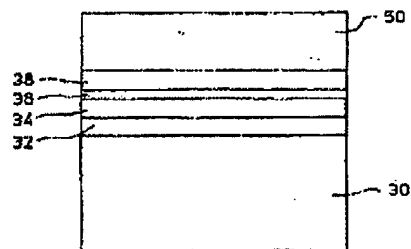
(14)

特開平6-302857

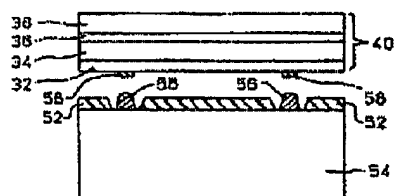
【圖5】



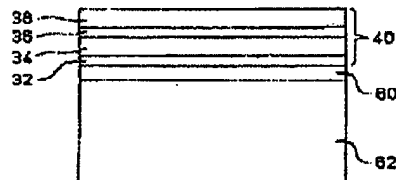
【圖6】



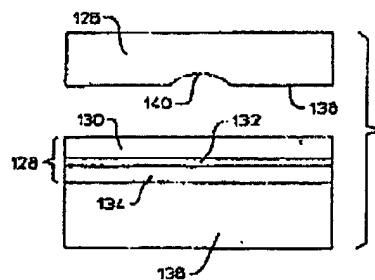
【圖7】



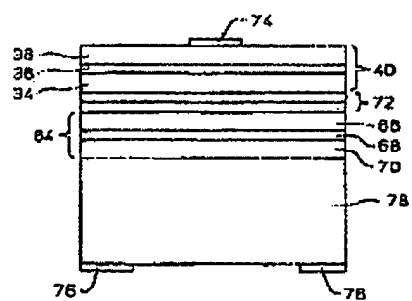
【圖8】



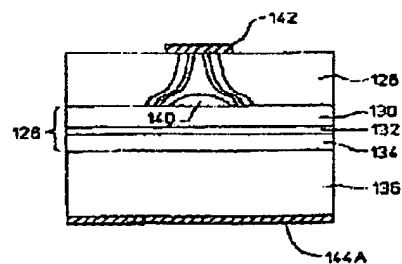
【圖10】



【圖9】



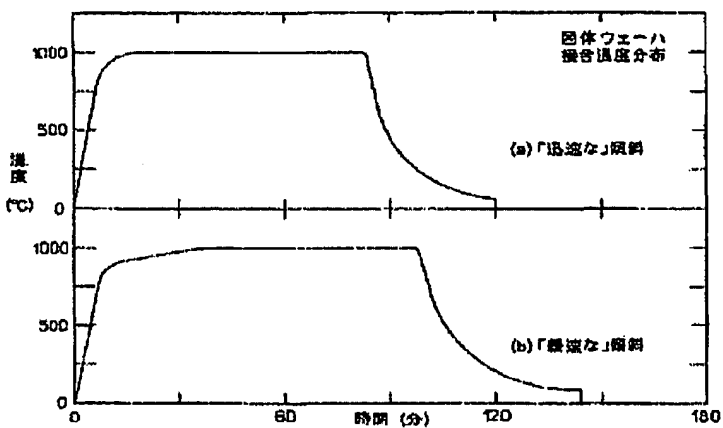
【圖11】



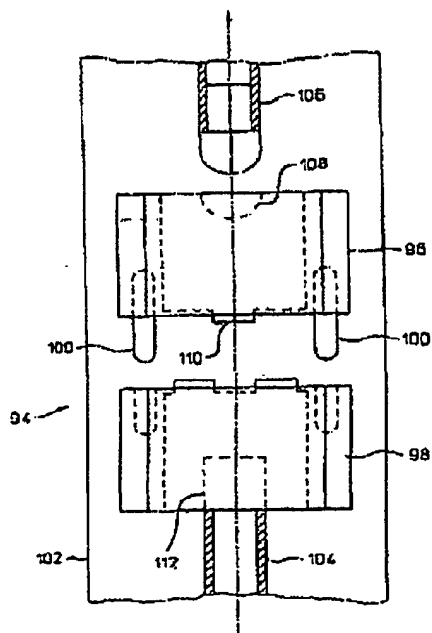
(16)

特開平6-302857

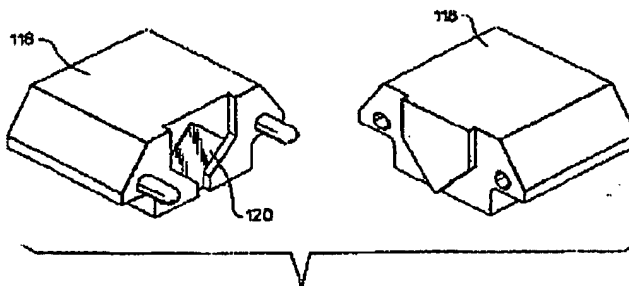
【図16】



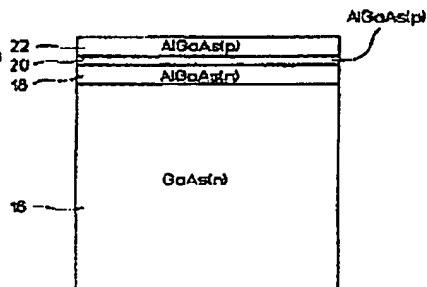
【図17】



【図19】



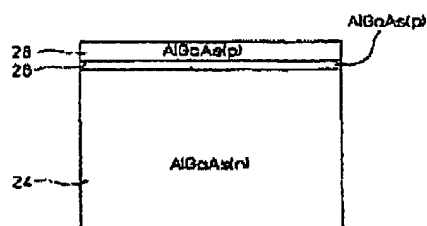
【図21】



(17)

特開平6-302857

【図22】



フロントページの続き

(72)発明者 デニス・シー・デフェヴレ
アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル
ト マダックス・ドライブ 1043

(72)発明者 ヴァージニア・エム・ロビンス
アメリカ合衆国カリフォルニア州ロスガト
ス グリーンウッド・ドライブ 17963

(72)発明者 ジョン・ウエビング
アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル
ト トウル・ウェイ 885

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.